（上接B343版）

募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。

八、保荐机构核查意见

保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目事项已经董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

综上，保荐人对有研硅及其子公司山东有研半导体部分募投项目延期及新增募投项目的事项无异议。保荐人提示公司严格按照变更后的募投项目计划加快推进募投项目实施进度，并密切跟踪市场环境变化、积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响，如发生重大变化应及时调整，履行相应的决策程序，并及时进行信息披露。

九、关于本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目提交股东会审议的相关事宜

公司本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年10月28日

证券代码：688432　证券简称：有研硅　公告编号：2025-036

有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月27日，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划的预留部分考核进行了明确，现将有关事项说明如下：

一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司2024股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》，股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》，薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、预留授予部分考核情况说明

（一）公司层面业绩考核要求

为更好地发挥股权激励作用，确保公司长期发展目标的实现，公司结合相关法律法规的规定和实际授予情况，进一步明确预留部分公司业绩考核要求，具体如下：

本激励计划预留授予部分考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2024年（EBITDA）为基数，对考核年度的息税折旧摊销前利润进行考核，根据上述指标的完成情况核算各年度公司层面的行权比例。本激励计划授予的股票期权的行权安排及对应业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核年度	息税折旧摊销前利润（EBITDA）（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
预留授予部分第一个行权期	2025年	4.5亿元	4亿元
预留授予部分第二个行权期	2026年	4.8亿元	4.2亿元
预留授予部分第三个行权期	2027年	5.0亿元	4.4亿元

预留授予部分的行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到下述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

考核指标	业绩完成度	公司层面可行权比例X
2025年息税折旧摊销前利润EBITDA（A）	A≥Am	X=100%
	Am＞A≥4.20	X=80%
	4.20＞A≥An	X=50%
	An＞A	X=0%
2026年息税折旧摊销前利润EBITDA（A）	A≥Am	X=100%
	Am＞A≥4.40	X=80%
	4.40＞A≥An	X=50%
	An＞A	X=0%
2027年息税折旧摊销前利润EBITDA（A）	A≥Am	X=100%
	Am＞A≥4.60	X=80%
	4.60＞A≥An	X=50%
	An＞A	X=0%

注1：上述“息税折旧摊销前利润EBITDA”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据，且剔除本次及考核期间内其它后续激励计划股份支付费用影响的数值；

注2：本激励计划涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

（二）个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其行权额度。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权额度：

考核结果	A	B	C	D
个人行权比例	100%	80%	40%	0%

激励对象个人当期可行权数量=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（X）×个人层面行权比例（Y）。

激励对象当期因考核原因不得行权的股票期权，作废失效，不可递延至以后年度，由公司统一安排注销。

三、薪酬和考核委员会的意见

薪酬和考核委员会认为：本次公司进一步明确了预留部分股票期权行权的考核指标，有利于保障本次激励计划的顺利实施，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年10月28日

证券代码：688432　证券简称：有研硅　公告编号：2025-037

有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将具体调整事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的审批程序

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司2024股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》，股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权，本次实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、本次股票期权激励计划行权价格的调整说明

（一）调整原因

2025年4月25日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,247,621,058股，扣除回购股份3,555,336股，以此计算本次拟派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生派发股票红利的情况，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

（二）调整情况

根据公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派发股票红利的情况，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

P＝P0－V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。根据以上公式，本次调整后的行权价格=9.11-0.06=9.05元/股。公司董事会根据2024年第二次临时股东大会授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司股票期权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬和考核委员会意见

公司董事会薪酬和考核委员会认为：本次调整符合《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次股票期权激励计划调整行权价格、本次行权条件的成就及本次注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年10月28日

证券代码：688432　证券简称：有研硅　公告编号：2025-038

有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权拟行权数量：268.08万份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》，根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个行权期的行权条件已经成就。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司2024股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》，股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权，本次实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

（二）本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件

本激励计划股票期权首次授予部分的授予日为2024年10月10日，本次股权激励计划首次授予的股票期权分三次行权，第一个行权期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已成就，等待期已于2025年10月10日届满。

激励对象获授的股票期权需同时满足以下行权条件方可办理行权事宜：

行权条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	截至目前，公司未发生左述情形，满足本项行权条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	截至目前，激励对象未发生左述情形，满足本项行权条件。
（三）公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2023年（EBITDA）为基数，对考核年度的息税折旧摊销前利润进行考核，根据上述指标的完成情况核算各年度公司层面的行权比例。本激励计划授予的股票期权的行权安排及对应业绩考核目标如下表所示： 行权期｜业绩考核年度｜息税折旧摊销前利润（EBITDA）（A）｜目标值（Am）｜触发值（An） 首次授予部分第一个行权期｜2024年｜4.2亿元｜3.8亿元 首次授予部分第二个行权期｜2025年｜4.5亿元｜4亿元 首次授予部分第三个行权期｜2026年｜4.8亿元｜4.2亿元 行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到下述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。 考核指标｜业绩完成度｜公司层面可行权比例X 2024年息税折旧摊销前利润EBITDA（A）｜A≥Am｜X=100% Am＞A≥4.00｜X=80% 4.00＞A≥An｜X=50% An＞A｜X=0% 2025年息税折旧摊销前利润EBITDA（A）｜A≥Am｜X=100% Am＞A≥4.20｜X=80% 4.20＞A≥An｜X=50% An＞A｜X=0% 2026年息税折旧摊销前利润EBITDA（A）｜A≥Am｜X=100% Am＞A≥4.40｜X=80% 4.40＞A≥An｜X=50% An＞A｜X=0% 注1：上述“息税折旧摊销前利润EBITDA”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据，且剔除本次及考核期间内其它后续激励计划股份支付费用影响的数值； 注2：本激励计划涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。	根据普华永道出具的《普华永道中天会计师事务所关于有研半导体硅材料股份公司2024年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字(2025)第10003号），计算公司2024年EBITDA为4.11亿元，达到触发值但未达到目标值。按照左述业绩考核要求，本次激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，公司层面行权比例为80%。
（四）个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其行权额度。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权额度： 考核结果｜A｜B｜C｜D 个人行权比例｜100%｜80%｜40%｜0% 激励对象个人当期可行权数量=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（X）×个人层面行权比例（Y）。	82名激励对象的年度绩效考核结果为“A”，满足本项可行权比例为100%的行权条件；10名激励对象的年度绩效考核结果为“B”，满足本项可行权比例为80%的行权条件。

综上所述，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共计92名，可行权数量268.08万份，占获授股票期权数量比例为23.41%，占公司总股本约为0.21%。

（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法

鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。

三、本次行权的具体情况

1、授予日：2024年10月10日

2、行权数量：268.08万份

3、行权人数：92人

4、行权价格：9.05元/份（调整后）

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6、行权方式：批量行权

7、行权安排：自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，为2024年股票期权激励计划的首次授予部分的第一个行权期。公司管理层将根据相关法律法规的规定确定行权期，统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他相关手续。激励对象所持有的本次可行权的股票期权须在公司确定的行权窗口期内行权完毕；行权窗口期届满，当期未行权的股票期权不得再行权或递延至下一行权期，由公司予以注销。

8、激励对象名单及可行权情况

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（万份）	可行权数量（份）	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	方永义	董事长	40	96,000.00	24
2	张荣虎	董事、总经理	40	96,000.00	24
3	刘斌	副总经理	32	76,800.00	24
4	杨波	财务总监、董秘	32	76,800.00	24
5	闫志瑞	核心技术人员	32	61,440.00	19.2
6	李耀东	核心技术人员	27	64,800.00	24
7	吴志强	核心技术人员	22	52,800.00	24
8	宁永铎	核心技术人员	22	52,800.00	24
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共84人）			898	2,103,360.00	23.42
合计			1145	2,680,800.00	23.41

注1：上述激励对象不包括独立董事、监事。

注2：以上被激励的高级管理人员，均已经董事会聘任。

注3：以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

注4：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、本次注销股票期权的情况

鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司将注销该部分已授予但考核不达标的股票期权合计75.42万份。

五、董事会薪酬和考核委员会对激励对象名单的核实情况

公司董事会薪酬和考核委员会对激励对象名单进行核查后，认为公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的92名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可行权数量为268.08万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司管理层将根据相关法律法规的规定确定行权期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。实际可行权期限根据批量行权手续办理情况确定。

经核查，参与本次行权的董事、高级管理人员在此前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

七、股票期权费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用和资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次股票期权激励计划调整行权价格、本次行权条件的成就及本次注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年10月28日

证券代码：688432　证券简称：有研硅　公告编号：2025-039

有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”或“有研硅”）及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金（含超募资金）投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
- 投资金额：不超过人民币